

第30回研究会

日 時 : 平成21年12月19日(土) 13:30~17:00

会 場 : 同志社大学今出川キャンパス 寒梅館 2F 204 室

(詳細地図: http://www.doshisha.ac.jp/access/ima_campus.html)

京都市営地下鉄今出川駅2番出口を出て、北へ徒歩1分。Tel. 075-251-3199)

プログラム

1. 講 演 13:30~17:00

(1) レーザー加工による周期構造を利用した

メカニカルシールしゅう動面へのキャビテーションリングの形成とその効果

イーグル工業(株)

徳永雄一郎 氏

井上 秀行 氏

(2) 小型流体軸受における軸受端テーパシールからの油漏れに関する基礎研究

スピンドルデバイス研究所

菱田 典明 氏

同志社大学

平山 朋子 氏

松岡 敬 氏

元・京都大学

矢部 寛 氏

(3) 高速回転機械用動圧フォイル軸受の開発

大阪産業大学

林 和宏 氏

平佐多敬二 氏

2. 技術交流会(忘年会) 18:00~20:00

「ダイニングバーばんけっと Nishiki」

ふところ: 5,000 円

以上